

展示会へのご招待



ご招待状

ぜひ社内にてご回覧ください

宇宙ビジネスに関するすべてが集まる展示会

2026年 5月27日 [水] ~ 29日 [金] 10:00~17:00

東京ビッグサイト

主催:RX Japan(株)

日本シイエムケイが貴殿をご招待いたします

ブース:南展示棟1階 S4-25

高信頼性HDI

Variation of PPBU structure

車載向けビルドアップ配線板
実績No.1!

放熱対応

CMK-COMP シリーズ

銅ベース
Cu base

銅板にダイレクト放熱
Heat radiation directly
to Cu board.

銅コア
Cu core

基板全体に熱拡散
Heat-spread to
whole PWB.

内層厚銅
Inner circuit thick Cu

断面積拡大により
大電流を許容
High-current can be
allowed with thick Cu.

ワンストップソリューション

CMKにて基板製造を行い、協力会社にて部品調達、実装/組立まで対応、
最適なソリューションをご提供いたします

基板製造

部品調達

部品実装

組立

← CMK
生産工場にて

→ 実装協力工場+部品商社にて

共晶半田、医療実績、小ロットなど様々なご要求にお応えできる協力会社様と連携し、
部品実装はもちろん、部品調達・組立も対応いたします

シミュレーション解析

熱解析

配線幅の確保・VIA追加にて、放熱経路上の熱抵抗を低減し、放熱性能を向上させます。



こちらをスキャンして
事前登録をお願いいたします

※事前登録制の展示会のため、来場登録をしてからお越しくださいませ。

<https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1647735744464059-ZDY>

貴殿のご来場、心よりお待ちしております！